

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于向士兰集科提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）。士兰集科为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司本次拟按持股比例为士兰集科向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）申请的两笔中长期贷款所对应的合计 3.56811 亿元贷款本金及利息等费用提供第三方连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司为其实际提供的担保余额为 5.30 亿元，担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在逾期对外担保。

● 本次担保构成关联担保，尚须提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

（一）士兰集科为本公司重要的参股公司，本公司持有士兰集科 27.447% 的股权。现士兰集科因日常生产经营需要，拟向国开行厦门分行申请两笔中长期贷款。本公司拟按持股比例为士兰集科提供担保，具体如下：

1、士兰集科拟向国开行厦门分行申请中长期研发项目融资贷款 5 亿元，贷款期限 8 年。该笔贷款由本公司按照所持有的士兰集科 27.447% 的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保，即本公司为其 1.37235 亿元贷款本金及利息等费用提供担保。士兰集科的另一股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体投资集团”）的相关方按出资比例提供第三方连带责任保证担保；同时士兰集科以项目形成的主要工艺设备提供抵押担保。

2、士兰集科拟向国开行厦门分行申请中长期项目融资贷款 8 亿元，贷款期限 12 年。该笔贷款由本公司按照所持有的士兰集科 27.447%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保，即本公司为其 2.19576 亿元贷款本金及利息等费用提供担保。士兰集科的另一股东厦门半导体投资集团的相关方按出资比例提供第三方连带责任保证担保；同时士兰集科以项目形成的主要机器设备提供抵押担保。

3、本次担保无反担保。担保期限以后续签订的具体担保协议为准。

4、公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保，尚须获得公司股东大会的批准。

(二) 截至本公告披露日，公司为士兰集科实际提供的担保余额为 5.30 亿元，担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

(三) 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事陈向东、范伟宏依法回避表决。

## 二、被担保人暨关联人基本情况

### 1、被担保人士兰集科的基本情况

公司名称	厦门士兰集科微电子有限公司
统一社会信用代码	91350200MA31GA8Q1C
成立日期	2018年2月1日
注册地址	厦门市海沧区兰英路89号
法定代表人	裴华
注册资本	5,309,503,753元
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	芯片制造
经营期限	2018年2月1日至2068年1月31日
股权结构	厦门半导体投资集团有限公司持有61.987% 杭州士兰微电子股份有限公司持有27.447% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有10.566%
关联人关系介绍	公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为上市公司的关

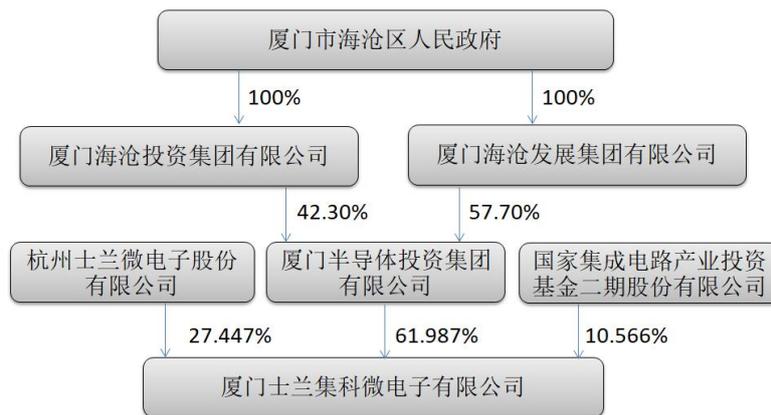
	关联方
关联人的资信状况	士兰集科未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项

2、士兰集科最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项目	2025年3月末/2025年1-3月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
资产总额	929,114	931,541
负债总额	572,427	575,230
净资产	356,687	356,311
营业收入	74,415	256,140
净利润	376	-12,404
资产负债率	61.61%	61.75%

3、截至目前，士兰集科股权结构如下：



### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。公司董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

### 四、担保的必要性和合理性

士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司，是公司 12 吋芯片产品的主要供应商。公司本次按持股比例向士兰集科提供担保，有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款，为其 12 吋集成电路芯片生产线的建设和运营

提供资金保障，从而为本公司提供产能保障，对本公司的经营发展具有长期促进作用。被担保人士兰集科生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、董事会意见

(一)公司于2025年4月18日召开的第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事认为：士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司，是公司12吋芯片产品的主要供应商。公司本次按持股比例向关联人士兰集科提供担保，有利于其获得国家开发银行中长期贷款，通过进一步加强研发活动和增资扩产，提高其自身的工艺能力和交付能力，对本公司的经营发展具有长期促进作用；本次担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响；本次关联交易公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(二)公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第三十三次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事陈向东、范伟宏依法回避表决。

(三)本次关联担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## 六、公司担保情况

截至目前，公司及控股子公司批准对外担保总额为45.566亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.30%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.62%；公司为士兰集科提供的担保总额为5.716亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度

与担保实际发生余额之和)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025年4月24日